

## 上海贝岭股份有限公司第一届第十三次董事会决议公告

上海贝岭股份有限公司于 2001 年 7 月 17 日在西郊宾馆会议室召开第一届董事会第十三次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，1 名董事委托其他董事参加。公司 6 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了如下事项：

一、关于计提固定资产、无形资产、在建工程和委托贷款减值准备的方法和内部控制制度的议案

二、公司 2001 年度中期报告及 2001 年度中期分配方案

公司 2001 年度中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。

三、公司符合增发 A 股条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会令第 1 号《上市公司新股发行管理办法》和证监发[2001]43 号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等有关法律、法规的规定，公司董事会结合公司实际情况逐一对照，对公司 2001 年增发资格进行自查，认为公司符合上述法律法规的有关规定，已经具备了增发 A 股的条件。出席公司本次董事会的全体董事对上述决议表决通过并依法承担相应的法律责任。

四、公司 2001 年度公募增发人民币普通股的议案

根据中国证券监督管理委员会令第 1 号《上市公司新股发行管理办法》和证监发[2001]43 号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》的规定，公司决定于 2001 年度增发 A 股：

1、公开发行股票类型：境内上市人民币普通股（A 股）。

2、每股面值：人民币 1 元。

3、股份数量：不超过 5000 万股。

4、发行对象：本次发行股权登记日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的上海贝岭 A 股流通股股东（以下简称“老股东”）、社会公众投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

5、发行方式：本次增发采用向社会公众投资者上网发行和向机构投资者网下配售相结合的发行方式，上网发行部分和网下配售部分将根据投资者认购情况互相进行回拨；在发行价格之上，有效申购的股权登记日登记在册的老股东可以按照所持股份以一定的比例获得优先配售。

6、定价方式：本次增发以预测的 2001 年度全面摊薄的每股收益乘以一定市盈率倍数为本次询价的下限，以增发招股意向书刊登前几个交易日收盘价的平均值为本次询价的上限，并在此区间内采用网上网下累计投标询价，在申购结束后，由发行人和主承销商根据网上网下的申购情况，按照一定的超额认购倍数最终确定发行价格。

7、募集资金用途及数额：

公司本次增发 A 股拟募集资金人民币约 80000 万元，主要投资于以下项目：

（1）投资建设 6 英寸数模混合集成电路生产线

该项目投资额为 78800 万元，其中 41500 万元为国债贴息贷款，其余 37300 万元将通过此次增发方式募集。

（2）投资建设集成电路芯片专用生产厂房

该项目投资额为 24813 万元，其中 11375.86 万元已通过公司节余的前次募集资金予以解决，其余 13437.14 万元将通过此次增发方式募集。

（3）建立 0.35—0.25 微米大规模集成电路设计及工艺研发技术平台

该项目投资额为 10001.5 万元。

（4）扩展经营及配套流动资金 20000 万元。

上述项目共需资金 80738.64 万元，公司本次增发 A 股募集资金若有剩余，将用于公司

后备项目的建设或补充公司流动资金；资金若有不足，公司将通过银行贷款等其他融资渠道予以解决。

8、增发决议有效期限：本次增发 A 股决议自公司 2001 年度第一次临时股东大会通过后一年内有效。

9、审议通过新老股东共同享受增发完成前未分配利润的议案：公司本次增发 A 股完成后，新老股东将共享未分配利润。

10、授权董事会全权处理本次增发有关事宜：提请股东大会授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议，制定和实施公司 2001 年度增发 A 股的具体方案，并全权负责办理和决定本次增发的发行时间、发行数量、询价区间、发行价格、网下申购的机构投资者类别、网上网下申购的比例、网上网下的回拨原则及细则、具体申购办法、原社会流通股股东的优先认购比例以及本次增发完成后办理工商变更登记、对《公司章程》中有关条款进行修改等有关事宜。

上述决议尚须经公司 2001 年度第一次临时股东大会表决通过后，报中国证券监督管理委员会核准。

根据国务院 6 月 12 日发布的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》，公司将在本次增发 A 股的过程中依照该办法规定按照筹资额的 10%减持国有股，同时上报财政部并按其最终审核意见实施国有股的减持。

#### 五、公司增发 A 股募集资金投资项目及可行性的议案

公司本次增发 A 股拟募集资金人民币约 80000 万元，主要投资于以下项目：

##### 1、投资建设 6 英寸数模混合集成电路生产线：

项目介绍：由于国内外通信、网络、数字化电子设备和智能家电等行业的迅速发展，导致数模混合电路的市场需求量也随之增长。为了适应市场需求，董事会决定建立 6 英寸 0.5—0.35 微米数模混合集成电路生产线。项目投资额为 7.88 亿人民币，主要用于进口设备。该工程将于 2001 年开始，预计 2002 年投产，达纲年形成投产能力 18 万片的生产规模，达纲年利润总额 33018 万元，全部投资财务内部收益率 26.7%，投资回收期 4.78 年。该项目经国家经贸委批准（国经贸投资[2001]83 号文），并列国家经贸委 2000 年国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划，同意给予该项目 41500 万人民币的贷款及 2 年的贴息款，其余 37300 拟通过增发股票募集资金解决。本项目的实施可使上海贝岭的集成电路生产技术提升二代以上，从 1.2 微米提升到 0.5—0.35 微米，能在一定程度上改变目前我国通信电路、金卡芯片、微控制器等大量依赖进口的现状，有利于加强上海贝岭在国际市场上的竞争能力。项目投资的可行性已经公司第一届第十一次董事会和 2000 年年度股东大会审议通过。

##### 2、投资建设集成电路芯片专用生产厂房：

项目介绍：为了配合公司 6 英寸 0.5—0.35 微米数模混合集成电路芯片生产线的建设，落实配套条件，满足集成电路生产用房的特殊需要，公司决定投资建设集成电路芯片专用生产厂房，厂房位于浦东张江高科技园区，建筑面积为 56620 平方米，购置安装净化、动力等相关设备。项目从 2001 年开始，建设期一年。项目的建设对加快公司生产线项目实施，迅速提升公司数模混合集成电路芯片制造水平起到积极推动作用。项目投资额 24813 万元人民币，使用节余的募集资金 11375.86 万元，不足部分 13437.14 万元通过增发股票募集资金解决。该项目经上海市经委（沪经技[2001]116 号）批准。项目投资的可行性已经公司第一届第十一次董事会和 2000 年年度股东大会审议通过。

##### 3、建立 0.35—0.25 微米大规模集成电路设计及工艺研发技术平台。

为了实施公司建设数模混合集成电路生产基地的战略目标，上海贝岭股份有限公司拟投资 10001.5 万元建立 0.35—0.25 微米大规模集成电路设计及工艺研发技术平台。本项目以上海贝岭国家级企业技术中心为基础，根据上海贝岭下一步发展战略需要和我国加入 WTO 后

微电子产业发展需要，提出了将上海贝岭国家级企业技术中心进一步提升到 0.35—0.25 微米大规模集成电路设计及工艺研发技术平台的方案。该中心的技术成果主要应用于公司新建数模混合电路生产线。

该项目投资总额为 10001.5 万元，拟通过增发股票募集资金解决。项目实施期间为 2002—2004 年共三年。经过本项目实施，上海贝岭技术中心的集成电路设计开发水平和工艺开发水平提升两代，全面提高了数模混合集成电路的开发、生产总体水平，并培养一大批设计开发和产业化的技术骨干。该项目能增加一批自主知识产权和专利，提升企业无形资产价值。本项目不涉及环境保护和基本建设等措施。

该项目业已报上海市经委立项审批。

#### 4、扩展经营及配套流动资金 20000 万元。

上述项目共需资金 80738.64 万元，公司本次增发 A 股募集资金若有剩余，将用于公司后备项目的建设或补充公司流动资金；资金若有不足，公司将通过银行贷款等其他融资渠道予以解决。

### 六、关于前次募集资金使用情况的说明

#### 前次募集资金数额和资金到位情况

经中国证监会证监发字（1998）217 号文批准，本公司于 1998 年 8 月 14 日在上海证券交易所上网公开发行 12,000 万股人民币普通股股票（含公司职工股 759.5 万股），扣除发行费用后共募集资金 76,812.04 万元。募集资金到位时间为 1998 年 9 月；业已经大华会计师事务所验证并出具验资报告[华业字 98 第(969)号]。

《招股说明书》对募集资金用途的承诺：

单位：万元

| 项 目 名 称                | 计划投资      | 计划完成时间 |
|------------------------|-----------|--------|
| 1. 建设通信产品用 IC 生产基地     | 16,600    | 2000   |
| 2. 建设金卡工程 IC 芯片生产基地    | 24,070    | 2000   |
| 3. 增添 6 英寸亚微米生产线专用设备   | 24,900    | 1999   |
| 4. 模糊控制专用 IC 芯片技术开发    | 597.6     | 1999   |
| 5. 改造扩建公司净化厂房          | 24,900    | 1999   |
| 6. 发展兼并后的上海华旭微电子公司封装分厂 | 1,050     | 1998   |
| 7. 流动资金配套              | 11,150    | 1999   |
| 合 计                    | 103,267.6 |        |

由于市场及经营情况发生了变化，公司对部分募集资金使用项目进行了调整，调整情况如下：

（一）公司于 1999 年 11 月 9 日召开一届七次董事会，董事会详细讨论了当前和未来市场需求，从降低投资成本，获取最大收益出发，慎重研究了 6 英寸亚微米生产线设备的改造和扩建净化厂房这两个项目的实施方案和投资方式，充分考虑了公司目前的产品研发和生产状况以及营销网络建设情况，决定对募集资金做如下调整：

1. 取消原“增添 6 英寸亚微米生产线专用设备”项目；
2. 取消原“改造扩建公司净化厂房”项目；
3. 出资 1500 万美元收购北电网络在上海先进半导体制造有限公司的全部股权；
4. 出资 153 万美元收购上海虹日国际电子有限公司 25.5% 的股权。
5. 对原“模糊控制专用 IC 芯片技术开发”项目追加 1000 万元人民币投资。

该募集资金调整方案的董事会决议公告刊登于 1999 年 11 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》。上述方案业已经 1999 年 12 月 16 日召开的公司 1999 年度第二次临时股东大会通过。

（二）为了尽快落实节余募集资金的运用项目，更有效地使用募集资金，充分发挥投资

效益，增强公司整体竞争能力，给股东以优良的回报，公司 2001 年 3 月 9 日召开一届十一次董事会，对部分募集资金进行调整：

1、取消“发展兼并后的华旭封装分厂生产线”项目。封装分厂原为上海华旭微 电子公司所属的封装车间，在上海贝岭改制上市时以零净资产方式购并，贝岭原计划用募集资金投资 1050 万元，对封装分厂进行设备和技术改造。但经过两年的经营和对封装发展趋势的调研后，发现封装分厂的现状与目前的封装潮流、贝岭的战略要求存在较大的差距，原计划的投资额对其升级换代不经济，不能形成规模效应。为此，公司董事会决定取消对封装分厂的投资。

2、结余的募集资金共计 11,375.86 万元，（其中：前次调整项目节余资金 7044.4 万元，改变华旭封装分厂项目节余资金 1050 万元，其它项目完成后节余资金 3281.46 万元），公司决定用于投资建设数模混合集成电路芯片专用生产厂房。该项目的建设总投资为 24,813 万元人民币，不足部分由公司自筹解决。

该募集资金调整方案的董事会决议公告刊登于 2001 年 3 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。上述方案业已经 2001 年 4 月 13 日召开的公司 2000 年度股东大会通过。

前次募集资金实际使用情况：

（一）前次募集资金实际使用情况：

单位：万元

| 项 目 名 称                          | 计划投资      | 实际投资      | 情况说明     |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1. 建设通信产品用 IC 生产基地               | 16,600    | 14,856.3  | 完成       |
| 2. 建设金卡工程 IC 芯片生产基地              | 24,070    | 8,267.53  | 完成 34%   |
| 3. 增添 6 英寸亚微米生产线专用设备             | 24,900    | 0         | 调整取消     |
| 4. 模糊控制专用 IC 芯片技术开发              | 1,597.6   | 1,597.6   | 追加投资。已完成 |
| 5. 改造扩建公司净化厂房                    | 24,900    | 0         | 调整取消     |
| 6. 发展兼并后的上海华旭微<br>电子公司封装分厂       | 1,050     | 0         | 调整取消     |
| 7. 流动资金配套                        | 11,150    | 11,150    | 完成       |
| 8. 收购北电网络在上海先进半导体<br>制造有限公司的全部股权 | 14,000    | 12,492.24 | 调整新增，已完成 |
| 9. 收购上海虹日国际电子有限公司<br>25.5%股权     | 1,300     | 1,270     | 调整新增，已完成 |
| 10. 建造数模混合集成电路专用生产厂房             | 11,375.86 | 1,739.5   | 调整新增     |
| 合计                               |           | 51,373.17 |          |

（二）调整后项目实际完成与承诺差异比较如下：

单位：万元

| 项目                  | 计划投资  | 实际投入金额总计 | 1998 年<br>当期投入<br>完工进度 | 1999 年<br>当期投入<br>完工进度 | 2000 年<br>当期投入<br>完工进度 | 2001 年<br>当期投入<br>完工进度 |
|---------------------|-------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 建设通信产品<br>用 IC 生产基地 | 16600 | 14856.3  | 5895<br>35%            | 3447.3<br>56%          | 5514<br>100%           | —<br>—                 |
| 建设金卡工程 IC<br>芯片生产基地 | 24070 | 8267.53  | 3035<br>13%            | 2312.3<br>22%          | 1809.23<br>30%         | 1111<br>34%            |

|                                       |          |        |             |               |                |                  |
|---------------------------------------|----------|--------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| 模糊控制专用 IC<br>芯片技术开发                   | 1597.6   | 1597.6 | 424<br>27%  | 1049.7<br>92% | 123.9<br>100%  | —<br>—           |
| 流动资金                                  | 11150    | 11150  | 1700<br>15% | 7161.7<br>79% | 2288.3<br>100% | —<br>—           |
| 收购北电网络在<br>上海先进半导<br>体制造有限公司<br>的全部股权 | 12492.24 | —      | 12492.24    | —             | 100%           | —<br>14000       |
| 收购上海虹日国际电子有限<br>公司 25.5%股权            | 1300     | 1270   |             | 1270          | —<br>100%      | —<br>—           |
| 建造数模混合集成电路<br>专用生产厂房                  | 11375.86 | 1739.5 | —<br>—      | —<br>—        | —<br>—         | 1739.5<br>15.29% |

续上表：

| 项目                                    | 实际与承诺差异                        |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 建设通信产品<br>用 IC 生产基地                   | 按时完成，节余 1743.7 万元已调整至生产专用厂房项目  |
| 建设金卡工程 IC<br>芯片生产基地                   | 完成 34%，拟继续投入                   |
| 模糊控制专用 IC<br>芯片技术开发                   | 项目按时完成                         |
| 流动资金                                  | 项目按时完成                         |
| 收购北电网络在<br>上海先进半导体<br>制造有限公司的<br>全部股权 | 按时完成，节余 1507.76 万元已调整至生产专用厂房项目 |
| 收购上海虹日国际电子有限<br>公司 25.5%股权            | 按时完成，节余 30 万元已调整至生产项目          |
| 建造数模混合集成电路<br>专用生产厂房                  | 项目已经按时启动                       |

\* 尚未投入使用的募集资金 25,438.87 万元目前暂存银行。

(三) 募集资金具体使用情况说明如下：

前次募集资金使用取得了良好的经济效益，大部分项目投资收益超过了原项目可行性报告的预期效果。

(1) 通过通信产品用 IC 生产基地、金卡 IC 芯片基地和模糊控制专用 IC 芯片技术 开发等三个项目的实施，公司从一个接受技术转让为主的企业转化为自主开发产品为主的企业。

1998 年以来，公司自主开发新产品共 24 项，自主开发新工艺 3 项，自主开发新技术 2 项，申请专利 5 项，已授权专利 2 项。技术创新已成为上海贝岭技术的主流。由于上述项目资金的持续投入，大大增加了公司产能，提高了技术等级，提升了产品档次和技术含量，目前公司已形成了通信类、金卡类和智能家电类等三大类产品的产业化生产基地和销售网络，通信电路、2K 位存储卡芯片电子电度表电路连续两年被评为上海市名牌产品 100 强，三大类产品 1999 年初至 2000 年末累计取得销售收入 52,263 万元，销售毛利 22,835 万元。2001 年上半年实现销售收入 14,891 万元，销售毛利 6,575 万元。

(2) 公司于 2000 年收购上海先进半导体制造有限公司 34% 的股权，上海先进当年实现销售收入 74,314 万元，利润总额 27,944 万元。2001 年上半年实现销售收入 34,058 万元，利润总额 11,302 万元。截至 2001 年 6 月 30 日，公司持有的上海先进 34% 的股权，按照权益法核算的投资收益为 10536.49 万元。

(3) 公司于 1999 年 10 月收购上海虹日国际电子有限公司 25.5% 股权，2000 年以来，虹日公司经营业务有了很大的拓展，在国内手机、DVD 电路市场占有了一定份额，对日本、新加坡等地的出口业务有了突破。2000 年实现销售收入 75,914 万元，利润总额 1,282 万元，2001 年上半年实现销售收入 47,979 万元，利润总额 1,220 元。

(4) 建设金卡工程 IC 生产基地项目虽然由于市场和技术的因素，实际投入比计划投入滞后，但金卡基地初步建成并已产生效益。金卡新产品开发取得了一定的成果，存储卡芯片已形成系列产品；具有广阔市场前景的防伪卡芯片已陆续开始投放市场；三菱金卡系统通过三菱公司的质量论证，正式上机使用；被列为国家技术创新重点新产品的铁电体存储器非接触卡项目已经正式启动。1999 年、2000 年金卡系列产品累计实现销售收入 9,116 万元，销售毛利 1,276 万元。公司在建设新生产线的同时，将继续加快基地的建设，公司已对该项资金的投入作了安排。

(5) 数模混合集成电路芯片专用厂房项目顺利启动。公司按照董事会要求，组建了项目领导小组和工程指挥部，严格按照国家有关规定规范操作，目前项目已完成了概念设计、扩初设计、项目施工招投标工作，7 月份正式开工。净化设备的采购和人员培训也已开始。

(6) 截至 2000 年 6 月 30 日，公司已经投入募集资金共计 51,373.17 万元，尚未投入使用的募集资金 25,438.87 万元，占募集资金总额的 33%。公司目前已经安排了剩余资金具体使用计划。

公司董事会将前次募集资金实际使用情况与涉及公司各年度报告和其它信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，认为前次募集资金已经募足，实际使用情况与公司有关信息披露内容相符。项目都取得了良好的经济效益。

该议案将提交上海贝岭股份有限公司 2001 年度第一次临时股东大会审议。

七、关于对上海虹日国际电子有限公司贷款担保延期的议案

为支持虹日业务的进一步发展，我公司同意将对上海虹日国际电子有限公司于 2001 年 7 月 31 日到期的 2500 万元贷款的担保延期一年至 2002 年 7 月 31 日。

该项表决时，4 名关联董事回避表决。

八、关于公司董事会换届选举的议案

公司第一届董事会将于 2001 年 8 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第二届董事会由九名董事组成。根据公司股东推荐的下一届董事会董事候选人为：张文义先生、奚国华先生、蒋守雷先生、袁欣先生、徐智群先生、马迈先生、王伟谷先生、钱佩信先生、韦乐平先生。其中钱佩信先生、韦乐平先生为公司独立董事候选人。

该议案将提交上海贝岭股份有限公司 2001 年度第一次临时股东大会审议。

九、关于独立董事津贴的议案

1、独立董事在公司内不领取工资报酬，但由本公司在每年发放独立董事津贴 3 万元。

2、独立董事的津贴及其工作费用的开支，在董事会专项费用中列支，并列入公司财务预算。具体的津贴发放经董事长签字后由董事会办公室负责办理。

该议案将提交上海贝岭股份有限公司 2001 年度第一次临时股东大会表决。

#### 十、关于召开公司 2001 年度第一次临时股东大会的议案

根据本次董事会决议中应提交股东大会表决的有关内容，董事会决定召开公司 2001 年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1、会议时间：2001 年 8 月 24 日上午 9：00 时

2、会议地点：另行通知

3、主要议题：

(1) 审议公司符合增发 A 股条件的议案。

(2) 逐项审议公司 2001 年度增发不超过 5000 万股人民币普通股（A 股）的议案。

A、公开发行人股票类型

B、发行股票面值

C、增发 A 股数量

D、增发 A 股的发行对象

E、增发 A 股的发行方式

F、增发 A 股的定价方式

G、增发 A 股募集资金用途及数额

H、增发决议有效期限

I、增发 A 股完成后，新老股东共享未分配利润

J、授权董事会全权处理本次增发有关事宜

(3) 关于在本次增发 A 股同时根据国家规定实施国有股减持的说明。

(4) 审议本次募集资金项目可行性报告的议案。

(5) 审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案。

(6) 董事会换届选举。

(7) 监事会换届选举。

(8) 关于独立董事津贴的议案

4、出席会议对象：

(1) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(2) 2001 年 8 月 7 日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的股东；

(3) 因故不能出席者，可授权委托代表出席；

5、会议登记办法：

(1) 登记时间：2001 年 8 月 14 日，上午 9：00—11：30，下午 1：00—4：00

(2) 登记地点及联系人：上海市桂箐路 19 号上海电工技术交流中心（近田林路口，公交车 89、93、205、506、92）

联系人：董倩、郁春豪

电话：021—64850700—157

传真：021—64854424

(3) 登记手续：凡有资格出席股东大会的股东请持本人身份证、上海股票交易磁卡和持股凭证或委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证到指定地点办理登记手续，也可以传真或信函方式进行登记。

6、其他事项：

(1) 出席本次会议的所有股东凭会议通知和股票交易磁卡参加会议

(2) 本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

上海贝岭股份有限公司董事会

2001 年 7 月 21 日

附件：

#### 1、 董事候选人简介

张文义先生，55 岁，大学本科学历，高级工程师。曾任陕西彩色显像管总厂厂办副主任、分厂厂长、总厂副厂长、代厂长、厂长，彩虹电子集团公司总经理，陕西彩色显像管总厂厂长，中华人民共和国电子工业部副部长。现任上海华虹（集团）有限公司副董事长、总裁，上海华虹 NEC 电子有限公司董事长，上海贝岭股份有限公司董事长。

奚国华，49 岁，硕士。曾任上海市电报局副局长、上海市长途电信局局长、上海市邮电管理局电信处副处长、上海市邮电管理局副总工程师、邮电部电信总局副局长、上海邮电管理局副局长等职。现任上海贝尔有限公司董事长兼执行副总裁，上海贝岭股份有限公司副董事长。

蒋守雷先生，现年 58 岁，大学本科学历，高级工程师。曾任电子工业部七四二厂副厂长、厂长，无锡华晶微电子联合公司副总经理，中国华晶电子集团公司副总经理，华越微电子有限公司总经理，上海华虹微电子有限公司副总经理。现任上海华虹（集团）有限公司副总裁，上海虹日国际电子有限公司董事长，上海华虹计通智能卡系统有限公司董事长，上海贝岭股份有限公司董事，上海先进半导体制造有限公司董事。

袁欣先生，现年 38 岁，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海贝尔电话设备制造有限公司生产部副经理、生产供应部经理、总经理助理，现任上海贝尔有限公司商务副总裁，上海贝岭股份有限公司董事。

徐智群先生，现年 42 岁，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海贝尔电话设备制造有限公司工程师、技术部副经理、总经理助理，现任上海贝尔有限公司科技副总裁，上海贝岭股份有限公司董事。

马迈先生，现年 52 岁，大学本科学历，高级工程师。曾任上海无线电十七厂技术科副科长、车间主任、中外合资上海新玻电子有限公司执行总经理、上海无线电十七厂副厂长，上海麦克电子有限公司总经理。现任上海贝岭股份有限公司董事、总经理，上海先进半导体制造有限公司董事。

王伟谷先生，现年 54 岁，大专学历，高级经济师。曾任上海天平仪器厂车间主任、技校副校长、计划科科长、计划销售科科长，上海仪表电讯工业局经营生产处、对外经济合作处科长、副处长，上海仪电控股集团公司综合部副经理、上海华虹微电子有限公司综合部经理，现任上海华虹（集团）有限公司董事会办公室副主任、发展部部长，北京华虹集成电路设计有限公司董事。

钱佩信先生，64 岁，大学学历，研究员。1993—2000 年任清华大学微电子学研究所所长。现任清华大学信息科学技术学院副院长、北方微电子基地集成电路开发和工业试验线主任。兼任中国电子学会学术工作委员会委员、中国电子学会半导体与集成电路分会委员、中国电子学会会士、“半导体学报”编委、有色金属学会半导体材料分会副主任、国家自然科学基金会监督委员会委员和国家杰出青年基金评审委员会委员、上海贝岭股份有限公司独立董事。

韦乐平先生，55 岁，硕士学历，教授级高工。曾任邮电部电信传输研究所高级工程师、副总工程师、副所长兼总工程师、信息产业部电信研究院副院长。现任中国电信集团公司总工程师兼研究院院长、国家 863 通信高技术主题专家组副组长和中国高速信息示范领导小组组长、信息产业部邮电科学技术委员会常委、通信学会光通信委员会委员、上海贝岭股份有限公司独立董事。

#### 2、 监事候选人简介

雷见辉女士，现年 64 岁，大学本科学历。助理研究员，曾任上海市物资局党委副书记，上海市纪律检查委员会常委，上海市工业党委副书记兼纪委书记，同时兼任原上海冶金控股集团公司监事长，原上海梅山钢铁集团公司的副监事长。现任上海华虹（集团）有限公司党委书记、副总裁，上海华虹计通智能卡系统有限公司监事长，上海华虹集成电路有限公司董事，上海贝岭股份有限公司监事长。

周斌先生，现年 56 岁，大专学历，高级政工师。曾任邮电部五二 0 厂车间副主任、支部书记、党办副主任，现任上海贝尔电话设备制造有限公司党委委员、工会主席，上海贝岭股份有限公司监事。

袁吉祥先生，现年 58 岁，大学本科学历，高级工程师。曾任上海 101 厂车间副主任、设计科副科长、组织干部科副科长，上海仪表电讯工业局人事干部处科长、副处长，上海仪电控股集团公司人事部副经理，上海华虹微电子有限公司人力资源部经理，上海华虹（集团）有限公司人力资源部部长，现任上海华虹（集团）有限公司党委办公室主任，上海华虹计通智能卡系统有限公司董事，上海贝岭股份有限公司监事。

蒋永祥先生，现年 32 岁，博士学历。曾任上海复旦大学电子工程系讲师，本科生辅导员，党支部书记，党总支委员，上海华虹（集团）有限公司综合部副部长，办公室副主任，现任上海华虹（集团）有限公司发展部副部长，上海贝岭股份有限公司监事。

### 3、授权委托书

兹授权                先生（女士）代表我单位（个人）出席上海贝岭股份有限公司 2001 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：此委托书剪贴或复印均有效

## 前次募集资金使用情况专项报告

上海贝岭股份有限公司董事会：

我们接受委托，审核了贵公司截至 2001 年 6 月 30 日前的前次募集资金投入情况。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们责任是对这些材料和证据发表审核意见。我们的审核是根据《中国注册会计师独立审计准则》和中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求进行的。在审核过程中，我们结合贵公司的具体情况实施了包括调查、取证等我们认为必要的审核程序。现将审核情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会核准，贵公司于 1998 年 8 月 14 日发行新股。发行股份 12,000 万股，发行股价人民币 6.53 元，募集资金总额为人民币 783,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,479,578.30 元后实际募集资金数额为人民币 768,120,421.70 元。资金到位时间为 1998 年 8 月 24 日，业经大华会计师事务所以华业字（1998）第 969 号验资报告验证。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

#### （一）前次募集资金的实际使用情况：

金额单位：人民币万

元

| 序号 | 项目名称                            | 实际投资<br>资金额 | 1998 年    | 1999 年    | 2000 年    | 2001 年   | 完工<br>程度 | 产生收益       |
|----|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| 1  | 建设通信产品用 IC<br>生产基地              | 14,856.30   | 5,895.00  | 3,447.30  | 5,514.00  | -        | 100%     | -          |
| 2  | 建设金卡工程 IC 芯<br>片生产基地            | 8,267.53    | 3,035.00  | 2,312.30  | 1,809.23  | 1,111.00 | 34%      | -          |
| 3  | 模糊控制专用 IC 芯<br>片技术开发            | 1,597.60    | 424.00    | 1,049.70  | 123.90    | -        | 100%     | -          |
| 4  | 流动资金                            | 11,150.00   | 1,700.00  | 7,161.70  | 2,288.30  | -        | 100%     | -          |
| 5  | 收购北电网络在上<br>海先进半导体有限公<br>司的全部股权 | 12,492.24   | -         | -         | 12,492.24 | -        | 100%     | *10,536.49 |
| 6  | 收购上海虹日国际电子<br>有限公司 25.5%股权      | 1,270.00    | -         | 1,270.00  | -         | -        | 100%     | 477.92     |
| 7  | 建造数模混合集成电路<br>专用生产厂房            | 1,739.50    | -         | -         | -         | 1,739.50 | 15.29%   | -          |
| 合计 |                                 | 51,373.17   | 11,054.00 | 15,241.00 | 22,227.67 | 2,850.50 | -        | -          |

系根据贝岭公司所持股权比例按照权益法核算的投资收益。

募集资金投入的通信产品用 IC 生产基地、金卡工程 IC 芯片生产基地、模糊控制专用 IC 芯片技术开发三个项目所产出的三大类产品，于 1999 年初至 2000 年末累计实现销售收入 52,263 万元，销售毛利 22,835 万元；2001 年上半年实现销售收入 14,891 万元，销售毛利 6,575 万元。

(二) 募集资金实际使用情况与招股说明书中的承诺对照如下：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称                  | 实际投资金额    | 招股说明书<br>承诺金额 | 差异说明                                 |
|----|-----------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|
| 1  | 建设通信产品用 IC<br>生产基地    | 14,856.30 | 16,600.00     | 结余 1,743.70 万元已调整至建造<br>数模混合集成电路厂房项目 |
| 2  | 建设金卡工程 IC 芯<br>片生产基地  | 8,267.53  | 4,070.00      | 项目尚未完成                               |
| 3  | 增添 6 英寸亚微米生<br>产线专用设备 |           |               |                                      |

|                       |           |             |                                |     |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------------------------|-----|
|                       | 0.00      | 24,900.00   | 项目取消                           |     |
| 4 模糊控制专用 IC 芯片技术开发    |           |             |                                |     |
|                       | 1,597.60  | 597.60      | 调整增加投资 1000 万元                 | 5 改 |
| 造扩建公司净化厂房             |           |             |                                |     |
|                       | 0.00      | 24,900.00   | 项目取消                           |     |
| 6 发展兼并后的上海华旭微电子公司封装分厂 |           |             |                                |     |
|                       | 0.00      | 1,050.00    | 项目取消                           | 7 流 |
| 动资金                   |           |             |                                |     |
|                       | 11,150.00 | 11,150.00   | 无差异                            |     |
| 8 收购北电网络在上海先进半导体有限    |           |             |                                |     |
|                       |           |             | 调整新增项目，结余 1,507.76 万元已调整至建造数模混 |     |
| 公司的全部股权               |           |             |                                |     |
|                       | 12,492.24 |             | 集成电路厂房项目                       |     |
| 9 收购上海虹日国际电子有限        |           |             |                                |     |
|                       |           |             | 调整新增项目，结余 30 万元已调整至建造数模混合集成    |     |
| 公司 25.5%股权            |           |             |                                |     |
|                       | 1,270.00  |             | 电路厂房项目                         |     |
| 10 建造数模混合集成电路专用生产厂房   |           |             |                                |     |
|                       | 1,739.50  |             |                                |     |
| 合计                    | 51,373.17 | *103,267.60 |                                |     |

\*公司实际募集资金数额为人民币 76,812 万元。

募集资金投资项目变更调整情况如下：

1. 公司于 1999 年 11 月 9 日召开第一届第七次董事会决定对募集资金作如下调整：

- (1) 取消原“增添 6 英寸亚微米生产线专用设备”项目；
- (2) 取消原“改造扩建公司净化厂房”项目；
- (3) 出资 1500 万美元收购北电网络公司在上海先进半导体制造有限公司的全部 股权；
- (4) 出资 153 万美元收购上海虹日国际电子有限公司 25.5%的股权；
- (5) 对原“模糊控制专用 IC 芯片技术开发”项目追加 1000 万元人民币投资。

该募集资金变更方案业经 1999 年 12 月 16 日召开的公司 1999 年度第二次临时股东大会通过。

2. 公司于 2001 年 3 月 9 日召开一届十一次董事会，对募集资金进行了调整：

- (1) 取消“发展兼并后的华旭封装分厂生产线”项目；
- (2) 结余的募集资金共计人民币 11,375.86 万元，用于投资建设数模混合集成 电路芯片专用生产厂房，该项目的建设总投资为人民币 24,813.00 万元，不足部分由公司自筹资金解决。

该项募集资金调整方案业经 2001 年 4 月 13 日召开的公司 2000 年度股东大会通过。

经过上述项目调整后募集资金的使用计划如下： 金额单位：人民币万元

| 项目名称             | 计划投资    |
|------------------|---------|
| 建设通信产品用 IC 生产基地  | 16,600  |
| 建设金卡工程 IC 芯片生产基地 | 24,070  |
| 模糊控制专用 IC 芯片技术开发 | 1,597.6 |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 流动资金                    | 11,150     |
| 收购北电网络在上海先进半导体有限公司的全部股权 | 14,000     |
| 收购上海虹日国际电子有限公司 25.5%股权  | 1,300      |
| 建造数模混合集成电路专用生产厂房        | 11,375.86  |
| 合计                      | *80,093.46 |

经过项目调整后使用计划总数大于实际募集资金数额，系因为建造数模混合集成电路专用生产厂房的计划投资中已包括了其他项目的结余资金 3,281.46 万元。

(三) 募集资金实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件的内容对照如下：

金额单位：人民币万元

| 序<br>号    | 项目<br>名称                   | 实际投资金额    |          |           | 各年度报告和其他信息披露文件 |           |  |
|-----------|----------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|-----------|--|
| 1998 年    | 1999 年                     | 2000 年    | 2001 年   | 1998 年    | 1999 年         | 2000 年    |  |
|           |                            |           | 中期       |           |                |           |  |
| 1         | 建设通信产品用 IC<br>生产基地         |           |          |           |                |           |  |
| 5,895.00  | 3,447.30                   | 5,514.00  | -        | ?,895.00  | 3,447.30       | 5,514.00  |  |
| 2         | 建设金卡工程 IC 芯<br>片生产基地       |           |          |           |                |           |  |
| 3,035.00  | 2,312.30                   | 1,809.23  | 1,111.00 | 3,035.00  | 2,312.30       | 1,809.23  |  |
| 3         | 模糊控制专用 IC<br>芯片技术开发        |           |          |           |                |           |  |
| 424.00    | 1,049.70                   | 123.90    | -        | 424.00    | 1,049.70       | 123.90    |  |
| 4         | 流动资金                       |           |          |           |                |           |  |
| 1,700.00  | 7,161.70                   | 2,288.30  | -        | 1,700.00  | 7,161.70       | 2,288.30  |  |
| 5         | 收购北电网络在上海<br>先进半导体         |           |          |           |                |           |  |
| -         | -                          | 12,492.24 | -        | -         | -              | 12,492.24 |  |
|           | 有限公司的全部股权                  |           |          |           |                |           |  |
| 6         | 收购上海虹日国际电子有限<br>公司 25.5%股权 |           |          |           |                |           |  |
|           | 1,270.00                   | -         | -        | -         | 1,270.00       | -         |  |
| 7         | 建造数模混合集成电路<br>专用生产厂房       |           |          |           |                |           |  |
| -         | -                          | -         | 1,739.50 | -         | -              | -         |  |
| 合计        |                            |           |          |           |                |           |  |
| 11,054.00 | 15,241.00                  | 22,227.67 | 2,850.50 | 11,054.00 | 15,241.00      | 22,227.67 |  |

续上表：

| 序<br>号 | 项目<br>名称             | 各年度报告和其他<br>信息披露文件 | 差异说明 |
|--------|----------------------|--------------------|------|
|        |                      | 2001 年中期           |      |
| 1      | 建设通信产品用 IC<br>生产基地   | -                  | 无差异  |
| 2      | 建设金卡工程 IC 芯<br>片生产基地 | 1,111.00           | 无差异  |

|                          |          |     |
|--------------------------|----------|-----|
| 3 模糊控制专用 IC 芯片技术开发       | -        | 无差异 |
| 4 流动资金                   | -        | 无差异 |
| 5 收购北电网络在上海先进半导体的全部股权    | -        | 无差异 |
| 6 收购上海虹日国际电子有限公司 25.5%股权 | -        | 无差异 |
| 7 建造数模混合集成电路专用生产厂房       | 1,739.50 | 无差异 |
| 合计                       | 2,850.50 |     |

(四) 募集资金实际使用情况与公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》对照表如下:

| 序号 | 项目名称                    | 实际投资      | 董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》披露金额 | 差异说明 |
|----|-------------------------|-----------|--------------------------|------|
| 1  | 建设通信产品用 IC 生产基地         | 14,856.30 | 14,856.30                | 无差异  |
| 2  | 建设金卡工程 IC 芯片生产基地        | 8,267.53  | 8,267.53                 | 无差异  |
| 3  | 模糊控制专用 IC 芯片技术开发        | 1,597.60  | 1,597.60                 | 无差异  |
| 4  | 流动资金                    | 11,150.00 | 11,150.00                | 无差异  |
| 5  | 收购北电网络在上海先进半导体有限公司的全部股权 | 12,492.24 | 12,492.24                | 无差异  |
| 6  | 收购上海虹日国际电子有限公司 25.5%股权  | 1,270.00  | 1,270.00                 | 无差异  |
| 7  | 建造数模混合集成电路专用生产厂房        | 1,739.50  | 1,739.50                 | 无差异  |
| 合计 |                         | 51,373.17 | 51,373.17                |      |

### 三、未全部使用募集资金情况

截至 2001 年 6 月 30 日止, 公司尚未使用的募集资金为人民币 25,438.87 万元, 均暂存于银行, 尚未使用的募集资金占前次募集资金总额的比例为 33%, 公司董事会已对结余资金进行了具体安排。

我们认为, 贵公司董事会说明、有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

本专项报告仅供贵公司本次发行新股之目的使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司申请发行新股所必备的文件, 随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师  
中国·上海·昆山路 146 号 2001 年 7 月 18 日